

附件一：IC 新創加速平台資源需求申請表

辦法說明：

1. IC 新創加速平台藉助臺灣在半導體領先的實力與豐沛的資源，彙整晶片開發所需之關鍵資源，協助全球 IC 新創加速實現潛力產品。
2. 所提供之投資價值上限 300 萬美金。
3. 所提供之投資原則以 SAFE (Simple Agreement for Future Equity) 模式轉換為股權，若 SAFE 不適用於該國法規，將另議換股辦法，由行政院國家科學技術發展基金佔股。

詳細需求說明：(請詳細說明產品與需求細節，包括產品規格、製程節點、台灣廠商合作內容等)

☐ 產品名稱與功能方塊圖(Block diagram)：

☐ 產品規格：(請條列細節)

產品開發之資源需求：(可複選並說明)

☐ EDA tool 需求：_____

☐ IP 需求：_____

☐ IC 設計服務需求：_____

☐ 規劃投片晶圓廠：_____

☐ 製程節點：_____ nm

☐ 製程類型 type (GP, BCD, RF, Mixed-Signal...etc.)：_____

☐ 封測需求：_____

☐ 系統整合需求：_____

☐ 產品開發之時程規劃：

☐ 已接洽過之臺灣廠商：

其他需求說明：(可複選並說明)

☐ 商務發展需求：_____

☐ 募資需求：_____

☐ 在台設立公司：_____

☐ 其他（可條列說明，如產品開發需求之額外補充....等）：_____

股權資料內容

股權結構：

股東名稱	國籍	持股比例

各輪募資金額及估值(台幣仟元)：

輪次	時間	募資金額 (仟元)	估值 (仟元)	累積實收資本額 (仟元)

上述資料須提供相關佐證：包含「股東名冊」、「各輪次募資「股款匯入證明」、「資本額」

簽名同意(公司以負責人或 CEO 簽署；未成立公司之團隊則需所有團隊成員簽署)：_____